

证券代码: 002845

证券简称: 同兴达

公告编号: 2023-065

深圳同兴达科技股份有限公司

关于子公司昆山芯片金凸块全流程封装测试项目 启动量产仪式的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、概述

作为先进封装芯片下游直接应用厂商,深圳同兴达科技股份有限公司(简称“公司”)深刻了解先进封装技术在 IC 中的重要作用,并看好其长期发展前景。随着电子消费市场不断复苏,芯片的需求量不断增加,本公司于 2021 年 12 月设立子公司昆山同兴达芯片封测技术有限责任公司(简称“昆山同兴达”),逐步投建实施“芯片金凸块(GoldBump)全流程封装测试项目”项目(一期),助力国内芯片完整供应链,提升公司未来综合竞争力。

2023 年 10 月 18 日,昆山同兴达芯片金凸块全流程封装测试项目量产仪式在昆山隆重举行,下游客户包括奕力科技股份有限公司等国际知名 IC 设计大厂莅临参加,标志公司先进封装测试项目大规模量产化与市场化开启,进一步深化了与上游公司的合作模式。

二、对公司的影响

本次量产仪式契合了同兴达的战略发展规划,符合国家对半导体产业链发展的战略支持,有助于公司向产业链前端领域延伸布局,开拓了新的业绩增长点,提高了公司综合竞争力,提升经营效益与盈利水平,符合公司及全体股东的利益。

三、风险提示

公司芯片金凸块全流程封装测试项目在市场销售过程中不排除可能存在的

市场变化风险，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

深圳同兴达科技股份有限公司

董事会

2023年10月18日